



# eSMP® 系列

用于选定二极管和整流器的小尺寸和低型面高度封装解决方案

## 快速了解

### eSMP® 封装

#### 增强型表面贴装功率封装



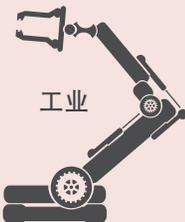
利用可提供更出色**热性能**和**可靠性的独特设计**支持更高的**电流**和**功率效率**



### eSMP®系列封装提供的产品技术:

- ESD 保护二极管
- PAR® TVS 二极管
- TRANSZORB® TVS 二极管
- 齐纳二极管
- 雪崩整流器
- FRED Pt® 整流器
- 肖特基整流器
- 标准和快速恢复整流器
- TMBS® 整流器
- 超快恢复整流器

### 应用



有用链接



eSMP® 系列产品概述:

[www.vishay.com/doc?49383](http://www.vishay.com/doc?49383)

采用 eSMP® 系列封装的二极管/整流器:

[www.vishay.com/landingpage/tradeshows/diodes/](http://www.vishay.com/landingpage/tradeshows/diodes/)

### 提供不对称和对称扁平式封装

技术问题垂询: [DiodesAmericas@vishay.com](mailto:DiodesAmericas@vishay.com)、[DiodesEurope@vishay.com](mailto:DiodesEurope@vishay.com) 或 [DiodesAsia@vishay.com](mailto:DiodesAsia@vishay.com)